

ИЗМЕНЕНИЕ ВЫСОТЫ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО БАРЬЕРА КОНТАКТОВ МЕТАЛЛ—КРЕМНИЙ В УСЛОВИЯХ ДЕФОРМАЦИИ

Фастыковский П. П., Канчуковский О. П.

Изучение влияния деформации на высоту потенциального барьера контактов металл—полупроводник, в частности широко используемых контактов металл—кремний, представляет интерес как с точки зрения физики таких контактов, так и для прикладных целей. Существующие модели, однако, позволяют лишь качественно описать зависимость высоты барьера φ_0 от прикладываемого давления P .

Для более адекватного описания процессов, происходящих с изменением высоты потенциального барьера контактов металл—кремний в условиях деформации, в работе использовалась модель контакта металл—полупроводник с промежуточным диэлектрическим слоем и поверхностными состояниями, содержащими в их спектре дискретный поверхностный уровень, близко расположенный к уровню электронейтральности поверхности. Кроме того, учитывалась возможность энергетического смещения уровня при деформировании контакта. Полученное аналитическое выражение для величины $\partial\varphi_0/\partial P$ подтверждено экспериментально на контактах молибден—кремний.

Исследование поведения высоты потенциального барьера контактов металл—полупроводник, в частности широко используемых контактов металл—кремний в условиях деформации, представляет интерес как с точки зрения физики таких контактов, так и для прикладных целей. Анализ имеющихся работ по этому вопросу, например [1-3], показывает, что при деформировании контактов (чаще всего одноосном сжатии) всегда происходит уменьшение высоты их потенциального барьера φ_0 , что качественно связано с уменьшением ширины запрещенной зоны кремния E_g при различных видах деформации [4]. При этом часто величина $\partial\varphi_0/\partial P \gg \partial E_g/\partial P$, где P — производимое давление на контакт. Пытаясь объяснить этот факт, в работе [5], исходя из модели контакта с промежуточным диэлектрическим слоем и равномерно распределенной по ширине запрещенной зоны плотностью поверхностных состояний, а также полагая $\gamma \rightarrow 0$ (предел Бардина), где $\gamma = \varepsilon_0 \varepsilon_i / (\varepsilon_0 \varepsilon_i + q^2 \delta D_s)$, ε_i — относительная диэлектрическая проницаемость промежуточного слоя, δ — его толщина, D_s — плотность поверхностных состояний в единичном интервале энергий (в эВ⁻¹·см⁻²), получили следующее соотношение для величины $\partial\varphi_0/\partial P$:

$$\left| \frac{\partial\varphi_0}{\partial P} \right| = \left| \frac{\partial E_g}{\partial P} \right| + \left| \frac{\partial\varphi_0}{\partial P} \right|, \quad (1)$$

где φ_0 — энергия уровня электронейтральности, отсчитываемая от потолка валентной зоны.

Из (1) следует, что при $\partial\varphi_0/\partial P \gg \partial E_g/\partial P$ $\partial\varphi_0/\partial P \gg \partial E_g/\partial P$. Однако, как отмечалось самими авторами работы [5], соотношение (1) лишь качественно объясняет экспериментальную зависимость φ_0 от P . Возможной причиной этого может быть некорректность использования исходной модели контакта применительно к реальным контактам. Действительно, известно, что для наиболее часто используемых контактов металл—кремний, изготовленных на травленной поверхности кремния, плотность поверхностных состояний имеет ярко выраженные максимумы, а величина γ может заметно отличаться от нуля [6, 7]. Кроме того, определение $\partial\varphi_0/\partial P$ по соотношению (1) затруднено из-за отсутствия достоверной информации о φ_0 и $\partial\varphi_0/\partial P$.

С целью получения аналитического выражения $\partial\varphi_0/\partial P$, более полно описывающего изменение высоты барьера реальных контактов металл—кремний в условиях деформации, можно воспользоваться моделью контакта с промежуточным диэлектрическим слоем и плотностью поверхностных состояний, имеющей на фоне равномерно распределенной по ширине запрещенной зоны плотности состояний ярко выраженный максимум при энергии E_s [6]. Если энергия E_s близка к φ_0 , высота барьера, согласно этой модели, определяется как

$$\varphi_0 = \gamma (\varphi_m - \chi_n - q\delta Q_s/\varepsilon_0\varepsilon_s) + (1 - \gamma) (E_g - E_s), \quad (2)$$

где Q_s — плотность заряда уровня E_s (энергия уровня E_s отсчитывается от потолка валентной зоны полупроводника у поверхности), φ_m — работа выхода металла, χ_n — электронное сродство полупроводника.

Полагая, что величины ε_s , δ , γ , φ_m и χ_n в пределах упругих деформаций меняются незначительно [8], из выражения (2) можно определить $\partial\varphi_0/\partial P$:

$$\frac{\partial\varphi_0}{\partial P} = -\frac{q\gamma\delta}{\varepsilon_0\varepsilon_s} \frac{\partial Q_s}{\partial P} + (1 - \gamma) \left(\frac{\partial E_g}{\partial P} - \frac{\partial E_s}{\partial P} \right). \quad (3)$$

Величину $\partial Q_s/\partial P$ можно определить, используя для акцепторного и донорного уровней соответственно следующие выражения: $Q_s^A = -qN_s f$ и $Q_s^D = qN_s(1-f)$, где f — функция распределения электронов на поверхностном уровне, N_s — плотность уровня (в см⁻²). Тогда

$$\frac{\partial Q_s^A}{\partial P} = -q \left[\frac{\partial N_s}{\partial P} f + N_s \frac{\partial f}{\partial P} \right], \quad (4)$$

$$\frac{\partial Q_s^D}{\partial P} = q \left[\frac{\partial N_s}{\partial P} (1-f) - N_s \frac{\partial f}{\partial P} \right], \quad (5)$$

$$\frac{\partial f}{\partial P} = -\frac{2 \exp[(E_s - E_F^s)/kT]}{kT \{2 + \exp[(E_s - E_F^s)/kT]\}^2} \left(\frac{\partial E_s}{\partial P} - \frac{\partial E_F^s}{\partial P} \right), \quad (6)$$

где E_F^s — энергетическое положение уровня Ферми полупроводника у поверхности, отсчитываемое от потолка валентной зоны.

Анализ выражений (4)–(6) показывает, что в общем случае изменение заряда уровня при деформации связано как с изменением плотности уровня, так и с его энергетическим смещением относительно уровня E_F^s .

Рассмотрим часто встречающуюся ситуацию в контактах металл—полупроводник, когда поверхностный уровень расположен вблизи уровня Ферми полупроводника у поверхности. Тогда вполне допустимо условие $N_s \partial f/\partial P > > \partial N_s/\partial P$. Учитывая экспериментальные результаты работ [5, 9], допустим также, что при деформации энергия поверхностного уровня относительно дна зоны проводимости кремния уменьшается, т. е. $\partial E_s/\partial P > 0$, а $\partial E_s/\partial P > > \partial E_F^s/\partial P$. Тогда из выражений (4), (5) следует, что величина $\partial Q_s/\partial P$ будет всегда положительна. А это означает, что первое слагаемое в выражении (3) всегда отрицательно, что соответствует уменьшению высоты потенциального барьера под давлением. Кроме того, учитывая, что в кремнии $\partial E_g/\partial P < 0$ [4], выражение (3) можно записать в следующем виде:

$$\frac{\partial\varphi_0}{\partial P} = -\frac{q\gamma\delta}{\varepsilon_0\varepsilon_s} \frac{\partial Q_s}{\partial P} - (1 - \gamma) \left(\left| \frac{\partial E_g}{\partial P} \right| + \left| \frac{\partial E_s}{\partial P} \right| \right). \quad (7)$$

Из полученного выражения, в частности, следует, что в кремниевых контактах высота потенциального барьера под давлением должна уменьшаться. Этот вывод соответствует всем имеющимся экспериментальным результатам. Кроме того, если $\partial E_s/\partial P \gg \partial E_g/\partial P$, то даже при $\partial Q_s/\partial P \rightarrow 0$ $\partial\varphi_0/\partial P \gg \partial E_g/\partial P$, что, как отмечалось выше, часто наблюдается экспериментально.

Из выражения (7) также следует, что если в запрещенной зоне кремния предполагаемый в исходной модели дискретный поверхностный уровень отсутствует либо присутствует, но практически не смещается под давлением относительно уровня Ферми у поверхности (например, вследствие пиннинга уровня Ферми

этим уровнем, что характерно для выпрямляющих контактов с минимальной толщиной промежуточного слоя [6]), то это выражение может быть записано следующим образом:

$$\frac{\partial \varphi_0}{\partial P} = -(1 - \gamma) \left| \frac{\partial E_g}{\partial P} \right|. \quad (8)$$

Один из этих вариантов, вероятно, реализовывался в тесных ($\delta \rightarrow 0$) контактах золото—кремний [10], где экспериментально было определено, что $|\partial \varphi_0 / \partial P| \approx 2/3 |\partial E_g / \partial P|$. Аналогичная ситуация может наблюдаться также в контактах металл—арсенид галлия, так как известно [11], что в этих контактах $\partial \varphi_0 / \partial P \ll \partial E_g / \partial P$.

Для экспериментальной проверки полученного выражения (7) изготавливались выпрямляющие контакты на кремнии с ориентациями (100) и (111). Выпрямляющим электродом контактов с учетом требуемых механических характеристик служил молибден, который наносился термическим испарением в вакууме. Для того чтобы иметь возможность определять энергетические положения поверхностных уровней и их изменения под давлением, используя стандартные вольфарадные методы, например [7, 12], в контактах перед нанесением молибдена с помощью термического окисления кремния создавался промежуточный окисный слой толщиной 50 Å; φ_0 и $\partial \varphi_0 / \partial P$ определялись как из ВФХ, так и по ВАХ. Давление на контакты в диапазоне от 0 до $7 \cdot 10^7$ Па создавалось с помощью плоского индентора перпендикулярно их поверхности, $T = 295$ К.

Проведенные исследования показали, что изготовленные контакты содержат в энергетическом спектре поверхностных состояний дискретные уровни акцепторного типа, в отсутствие смещения близко расположенные к уровню Ферми кремния. При деформировании контактов наблюдалось уменьшение энергии этих уровней относительно дна зоны проводимости кремния, причем $\partial E_g / \partial P > \partial E_F^* / \partial P$, что, с одной стороны, соответствовало результатам работ [5, 8], а с другой — подтверждало справедливость сделанных выше допущений.

Si	γ^*	$D_s \cdot 10^{-12}$ см ² · эВ ⁻¹	$N_s \cdot 10^{-12}$ см ⁻²	$\partial N_s / \partial P \cdot 10^{-12}$ см ⁻² · Па ⁻¹	$\partial E_g^* / \partial P \cdot 10^{11}$ эВ/Па	E_F , эВ	$\partial E_F / \partial P \cdot 10^{10}$ эВ/Па
(100)	0.9	0.5	2.0	4.3	-5.2	0.38	4.3
(111)	0.69	2.0	0.6	2.9	-3.8	0.38	5.7

Продолжение

$\partial E_F^* / \partial P \cdot 10^{10}$ эВ/Па	f^*	$\partial f^* / \partial P \cdot 10^{10}$ Па ⁻¹	$\partial Q_s^* / \partial P \cdot 10^8$ Кл/см ² · Па	Φ_B , эВ	$\partial \Phi_B / \partial P \cdot 10^{10}$ эВ/Па	$\partial \Phi_B^* / \partial P \cdot 10^{10}$ эВ/Па
2.9	0.77	-6.5	1.6	0.71	-2.9	-2.5
2.9	0.92	-4.8	0.05	0.68	-2.9	-2.0

Экспериментальные и расчетные (отмечены звездочкой) величины, входящие в выражение (7), представлены в таблице. Значения $\partial E_g / \partial P$ приведены из работы [4], а ϵ_s принималась равной 4.0, что для использованной в контактах толщины окисла согласуется с результатами работ [13, 14]. Сравнение экспериментально определенных величин $\partial \varphi_0 / \partial P$ с рассчитанными по выражению (7) показывает, что эти величины находятся в удовлетворительном соответствии.

Таким образом, использование модели контакта металл—полупроводник с промежуточным диэлектрическим слоем и поверхностными состояниями, содержащими в их спектре дискретный поверхностный уровень, близко расположенный к уровню электронейтральности поверхности, а также учет возможности энергетического смещения уровня при деформировании контакта позволяют более адекватно описывать процессы, происходящие с изменением высоты

потенциального барьера контактов металл—кремний в условиях деформации. Полученное выражение для величины $\partial\phi_c/\partial P$ подтверждено экспериментально на контактах молибден—кремний.

Список литературы

- [1] Kikuchi M., Saito M., Okushi H. // Sol. St. Commun. 1969. V. 7. N 5. P. 463—465.
- [2] Елисов М. И., Покалякин В. И., Полякова А. Л. // Радиотехн. и электрон. 1970. Т. 15. В. 1. С. 210—212.
- [3] Макаревич А. Б., Покалякин В. И., Полякова А. Л. // Акуст. журн. 1974. Т. 20. В. 3. С. 443—448.
- [4] Полякова А. Л. Деформация полупроводников и полупроводниковых приборов. М., 1979. 168 с.
- [5] Канчуковский О. П., Мороз Л. В., Садова Н. Н., Преснов В. А. // Изв. вузов СССР. Физика. 1984. № 5. С. 6—9.
- [6] Родерик Э. Х. Контакты металл—полупроводник. М., 1982. 208 с.
- [7] Стриха В. И., Бузанева Е. В., Радзиевский И. А. Полупроводниковые приборы с барьером Шоттки. М., 1974. 248 с.
- [8] Fonash S. J. // J. Appl. Phys. 1973. V. 44. N 10. P. 4607—4615.
- [9] Канчуковский О. П., Преснов В. А., Фастыковский П. П., Шенкевич А. Л. // Изв. вузов СССР. Физика. 1988. № 9. С. 65—69.
- [10] Кауфман М. С., Покалякин В. И., Степанов Г. В. // Радиотехн. и электрон. 1976. Т. 21. В. 11. С. 2446—2448.
- [11] Вяткин А. П., Максимова Н. К., Филонов Н. Г. // ФТП. 1978. Т. 12. В. 7. С. 1384—1387.
- [12] Terman L. M. // Sol. St. Electron. 1962. V. 5. N 3. P. 285—297.
- [13] Ковчавцев А. П., Французов А. А. // Науч. тр. ИФП СО АН СССР «Физические процессы в структурах МДП». Новосибирск, 1978. С. 37—44.
- [14] Монахов В. В., Романов О. В., Кириллов С. Н. // ФТП. 1986. Т. 20. В. 3. С. 477—480.

Одесский государственный университет
им. И. И. Мечникова

Получена 2.06.1989
Принята к печати 16.10.1989